

GROWTH RESEARCH

2026.03.23 (월)

[삼성 파운드리 산업보고서]

TSMC 독주 시대의 균열:
삼성 파운드리 부활에 베팅해야 하는 이유

Analyst. 한용희, 신지예, 손예진



목차

Part 1. 답 없는 사업부에서 황금알 낳는 거위

Part 2. 수율·TSMC 병목·테슬라-반등을 이끈 결정적 계기

Part 3. 삼성 파운드리가 살아나면 누가 가장 먼저 웃는가

Part 4. 관련 기업

기업분석

오픈엠티테크놀로지 (394280)

에스앤에스텍 (101490)

Intro

삼성 파운드리는 현재 수율 부진과 고객사 이탈이라는 암흑기를 지나, 이제는 **빅테크들의 '멀티벤더' 전략 속에서 가장 확실한 대안이자 파트너로 부상**하고 있다. 시장은 이미 움직이기 시작했다. 삼성 파운드리 반등은 선단 공정 주도권 탈환이라는 구조적 변화를 예고하고 있다.

그리고 2026년은 그 변화가 실적으로 증명되는 원년이다. 테슬라 등 글로벌 고객사의 대규모 수주가 양산으로 이어지고, 3나노와 2나노 공정의 안착 여부가 데이터로 평가받는다. 지금 삼성 파운드리 생태계를 주목해야 하는 이유는 명확하다. **기술적 신뢰를 회복했고, 가동률은 가파르게 상승 중이며, 그 온기가 밸류체인 전반으로 확산되고 있기 때문이다.**

본 보고서는 삼성 파운드리의 턴어라운드 전략과 기술적 로드맵을 분석하고, 생태계 확장의 직접적 수혜를 입을 핵심 섹터인 IP, DSP, 소부장 및 OSAT의 관계를 종합적으로 정리했다. 이를 바탕으로 독보적인 기술 해자와 실적 모멘텀을 보유한 국내 핵심 파트너사들의 투자 포인트를 심층 분석했다.

Part 1. 답 없는 사업부에서 황금알 낳는 거위

삼성 파운드리 부활의 신호탄 발사

'26년 1분기를 기점으로 삼성 파운드리는 마침내 긴 침체 터널을 지나 **극적인 반등에 성공하며 부활의 신호탄**을 쏘아 올렸다. '25년 한때 50%를 하회하던 전체 라인 가동률이 현재 80% 선을 돌파했으며, 특히 4나노·5나노·8나노 등 주력 공정 라인들은 90%에 육박하며 사실상 풀 가동 상태에 진입했다. '22년 이후 매 분기 약 1조 원의 적자를 기록 하던 파운드리 사업부는 수요 확대와 수율 안정화를 기반으로 **'26년 흑자전환을 할 것으로 기대되며, '27년 조 단위 영업이익 달성을 목표로** 선순환 사이클에 올라탄 것으로 보인다.

파운드리(Foundry) → 반도체 산업의 책임 시공사

파운드리는 반도체 설계 전문 기업인 팹리스로부터 설계도를 전달받아 실제 반도체 칩을 위탁 생산해 주는 거대한 **첨단 제조 공장**을 의미한다. 건설업에 비유하자면 설계자가 가져온 도면을 바탕으로 실제 건물을 한 치의 오차 없이 지어주는 **'시공사'**와 같은 역할을 수행한다. 삼성전자 파운드리 사업부는 수조 원에 달하는 천문학적인 시설 투자가 지속적으로 이루어졌음에도 불구하고, 오랫동안 투자 대비 수익을 내지 못해 전사 실적을 갹아먹는 '돈만 먹는 사업부' 혹은 '답 없는 사업부'로 불리며 침체기를 겪어왔다.

암흑기(2021~2024) → 붕괴된 신뢰와 대규모 고객 이탈

삼성 파운드리의 침체는 '21년에서 '22년 사이 발생한 기술적 참사와 신뢰 붕괴에서 시작되었다. **당시 주력 공정이었던 4나노 라인의 수율이 30%대에 머물 정도로 처참한 수준을 기록하며 생산 효율성이 극도로 악화**되었다. 이 공정에서 위탁 생산된 퀄컴의 '스냅드래곤 81세대' 칩이 심각한 전력 소모와 발열 문제를 일으켰고, 이를 해결하기 위해 삼성전자가 갤럭시 S22 시리즈에 소프트웨어적으로 성능을 강제 저하시키는 GOS(게임 최적화 서비스)를 적용하면서 하드웨어의 결함을 소프트웨어로 때우려 한다는 비판 직면과 함께 대외적인 신뢰가 완전히 무너졌다.

삼성 파운드리 반등에 관한 언론 기사

전자 > 장비

삼성 파운드리 "올해 흑자전환"

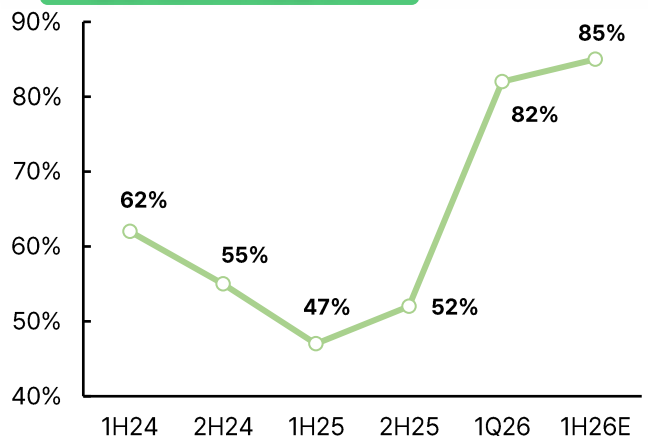
발행일: 2026-03-02 16:31 지면: 2026-03-03 1면

[단독] 삼성 파운드리, 내년 영업익 2조원 돌파 목표... 5년 만에 흑자 전환 시도

수주 부진 시달리던 삼성 파운드리
수율 안정화·수주 확대에 수익성 ↑
내년 연간 영업익 2조원 목표

전행수 기자
입력 2026.03.03. 16:01

삼성 파운드리 가동률 추이



자료: 디지타임스, 서울경제, ZDNet Korea, 글로벌이코노믹, 그로스리서치

**고객사 이탈 (Exodus)
→ 퀄컴·엔비디아의
TSMC 전환**

신뢰 붕괴는 곧바로 **글로벌 대형 고객사들의 대탈출(Exodus)**이라는 결과로 이어졌고 가장 큰 고객이었던 퀄컴은 차세대 핵심 칩셋인 스냅드래곤 8 2세대부터 모든 물량을 **TSMC로 전격 이전**했다. 엔비디아 역시 신형 그래픽카드인 RTX 40 시리즈와 고부가 가치 AI 칩 생산을 모두 **TSMC의 4나노 공정에 몰아주었다**. 이로 인해 삼성 파운드리는 **"삼성이 만든 칩은 성능이 나오지 않는다"**는 치명적인 낙인이 찍힌 채 시장에서 급격히 **고립**되기 시작하였다.

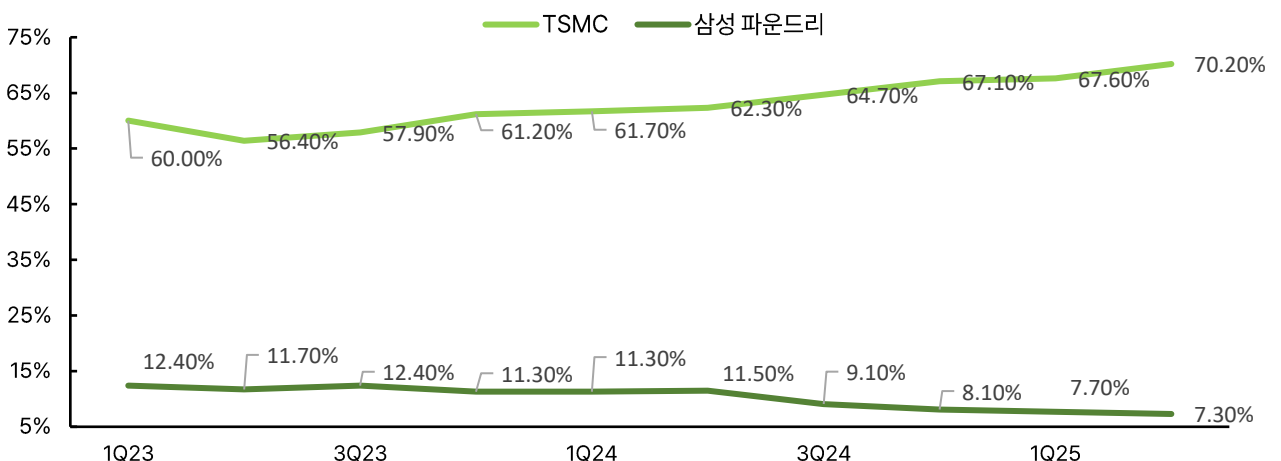
**AI반도체 시대 소외:
첨단 패키징 경쟁력 부
재와 점유율 붕괴**

'23년부터 본격화된 챗GPT 발 **AI반도체 열풍 속에서도 삼성은 첨단 기술 대응 실패로 인해 철저히 소외**되는 굴욕을 겪었다. 엔비디아 등 AI 칩 생산에 필수적인 '첨단 패키징' 기술력 확보와 생태계 구축이 늦어지면서 폭증하는 AI 수요를 TSMC가 독식하는 상황을 지켜봐야 했었다. 그 결과 '23년 초 12.4%였던 시장 점유율은 하락을 거듭하여 '25년 2분기 기준 7.3%라는 한 자릿수 점유율까지 추락했으며, **TSMC와의 격차는 60%p 이상 벌어지는 동시에 매분기 1조 원 규모의 천문학적인 영업적자를 기록**하며 사업부 존폐 위기론까지 대두되었다.

**2026년 턱어라운드
→ 가동률 회복과 흑자
전환 사이클 진입**

그러나 '26년 1분기를 기점으로 삼성 파운드리는 마침내 긴 침체 터널을 지나 극적인 반등에 성공하며 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. '25년 한때 50%를 하회하며 가동 중단 우려까지 제기되었던 **전체 라인 가동률이 현재 80% 선을 돌파하며 가파른 회복세**를 보이고 있다. 특히 4나노, 5나노, 8나노 등 범용성과 기술력을 동시에 갖춘 주력 공정 라인들은 가동률이 90%에 육박하며 사실상 '풀 가동' 상태에 진입했다. 수년간 이어온 조 단위 적자 고리를 끊어내고 **'26년을 흑자 전환의 원년으로 확정 지었으며, '27년 조 단위 영업이익 달성을 목표로 하는 완벽한 선순환 사이클에 올라탄 것으로 평가**받고 있다.

TSMC, 삼성 파운드리 시장 점유율 추이



Part 2. 수율·TSMC 병목·테슬라 - 반등을 이끈 결정적 계기

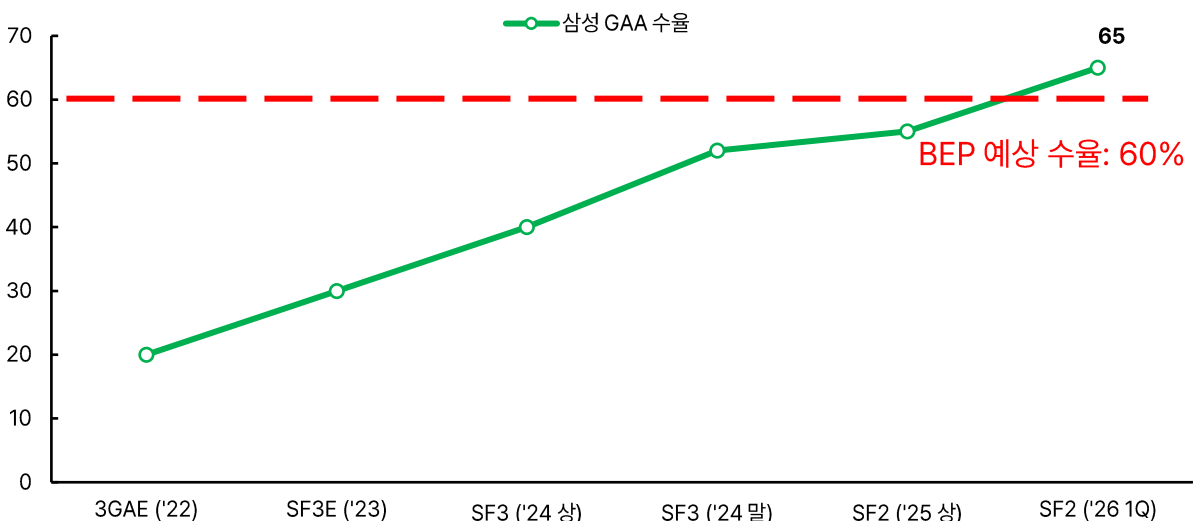
3대 핵심 반등 동력

'26년 들어 삼성파운드리는 과거의 부진을 털어내고 본격적인 반등 조짐을 보이고 있다. 이러한 극적인 변화를 이끌어낸 결정적인 계기는 크게 **1) 선단 공정 수율의 획기적 개선**, **2) TSMC의 공급 과부하에 따른 구조적 반사이익**, **3) 테슬라 수주를 통한 대외 신뢰성 회복으로 요약**된다. 수년간 삼성의 발목을 잡았던 고질적인 문제들이 해결됨과 동시에 외부 시장 환경이 삼성에 유리하게 재편되면서 '제2의 도약기'를 맞이한 것으로 분석된다.

선단 공정 수율 개선: GAA 기술의 안착과 BEP 달성

삼성파운드리의 최대 약점이었던 **선단 공정 수율 문제가 해소 국면에 접어들었다**. 업계에서 고객사가 대량 양산을 위탁하기 위해 요구하는 **손익분기점(BEP) 수율 마지노선은 통상 60~70% 수준**이다. 삼성파운드리 GAA의 수율 추이를 살펴보면, '22년 초기 3나노(3GAE) 공정 당시 20%에 불과했던 수율은 퀄컴과 엔비디아 등 대형 고객사의 이탈을 초래하는 원인이 되었다. 그러나 '24년 말 2세대 3나노(SF3) 수율이 50%대를 돌파한 데 이어, '26년 1분기 2나노(SF2) 수율이 60%대 후반까지 상승하며 본격적인 양산 궤도에 올랐다. 이는 **불량률 감소를 넘어 칩의 전력 효율과 성능 편차가 안정화되었음을 의미**하며, 퀄컴과 AMD 등 대형 팹리스들이 다시 삼성과 협상 테이블에 마주 앉게 만드는 결정적인 트리거가 되었다.

삼성파운드리 GAA 수율 추이



자료: 언론종합, 그로스리서치

TSMC의 공급 병목과 가격 정책에 따른 구조 적 반사이익

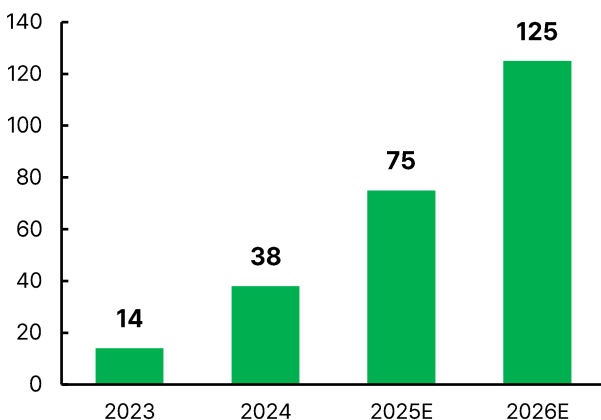
AI 산업의 팽창이 **TSMC의 공급 병목을 심화시키면서, 삼성 파운드리는 유일한 대안으로 부상하는 구조적 반사이익**을 누리고 있다. 현재 TSMC의 3나노 및 5나노 선단 공정 가동률은 사실상 100%에 달하는 풀 캐파 상태이며, AI 칩 생산의 필수 공정인 CoWoS 패키징의 리드타임은 평균 6개월 이상 지연되고 있다. 여기에 TSMC가 '25년 선단 공정 단가를 5~10% 인상하면서 글로벌 팹리스들의 마진 압박은 한계치에 도달했고, 이에 **엔비디아애플 등 빅테크 기업들은 공급 안정화와 가격 협상력 제고를 위해 '멀티 벤더' 전략**을 취하게 되었다. TSMC의 유일한 현실적 대안인 삼성 파운드리가 이 수요를 흡수하는 구조적 반사이익을 누리고 있는 것이다.

극적인 M&A 및 메가 딜 확대

삼성 파운드리 부활의 실질적인 물꼬를 튼 사건은 **테슬라와의 대규모 수주 계약**이다. '25년 7월 테슬라의 차세대 자율주행 칩인 'AI6' 생산을 위해 체결된 약 165억 달러 규모의 초대형 계약은 시장의 의구심을 불식시켰다. 자동차용 반도체는 인명과 직결되기 때문에 가혹한 온도 변화와 진동 테스트를 견뎌야 하며, **무엇보다 '신뢰성'이 최우선 가치**다. 퀄컴·엔비디아의 이탈로 '빅테크가 믿고 맡길 수 없는 곳'이라는 낙인이 찍혀 있던 삼성이, 전 세대 대비 3~5배 이상의 연산 성능이 요구되는 테슬라의 핵심 자율주행 로직 칩을 수주했다는 사실은 **제조 신뢰성 회복을 시장에 각인시키는 강력한 레퍼런스**가 되었다.

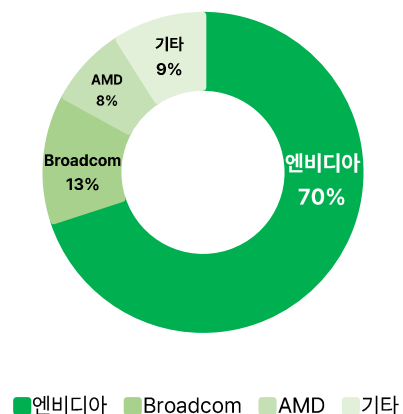
이후 수주 구조도 스마트폰 칩 위주의 편중에서 벗어나 다양한 분야의 포트폴리오로 다변화되고 있다. AI 데이터센터 분야에서는 **PFN-텐스토렌트에 이어 GTC 2026에서 Groq의 LPU를 삼성 4나노 공정으로 생산**하겠다는 계획이 공개되었고, 모바일에서는 **퀄컴의 플래그십 물량이 복구**했으며, 전장 분야에서도 **현대자동차 임베렐라와의 수주가 확대**되며 **모바일·AI 전장을 아우르는 고객 포트폴리오가 완성**되어 가고 있다.

TSMC CoWoS 월 생산량 추이



자료: 언론종합, 그로스리서치

고객사별 TSMC CoWoS 점유율



자료: 언론종합, 그로스리서치

Part 3. 삼성 파운드리가 살아나면 누가 가장 먼저 웃는가

삼성 파운드리 생태계의 핵심 밸류체인은 크게 IP, DSP(설계 대행사), 소재·부품·장비 및 OSAT로 구성된다.

[IP] 설계 자산 삼성 파운드리 필수 수요

IP 섹터는 팹리스가 칩을 설계할 때 반드시 필요한 검증된 회로 블록을 공정별로 인증해 라이선스로 공급하는 역할을 담당한다. 팹리스는 모든 회로를 처음부터 설계하는 대신, 메모리 인터페이스나 CPU 코어와 같이 자주 쓰이는 회로 블록을 **IP 업체로부터 구매해 활용**한다. 건축으로 비유하면 문창문·계단과 같은 규격 부품을 납품하는 업체에 해당한다. 핵심은 **IP가 각 파운드리**의 **공정별로 별도 인증**되어야 한다는 점으로, 트랜지스터의 물리적 특성이 공정마다 상이하기 때문이다. 따라서 고객이 삼성 파운드리를 선택하는 순간 삼성 공정에 맞게 인증된 IP에 대한 수요가 자동으로 창출되며, 삼성 파운드리 고객이 늘어날수록 IP 업체의 매출도 연동되어 확대되는 구조를 갖는다. **주요 기업으로는 오픈엠티테크놀로지, 쉐라타스반도체** 등이 있다.

[DSP] 설계 대행사 팹리스의 설계를 최적화

DSP(설계 대행사) 섹터는 보통 디자인하우스로 불리며, **팹리스의 설계를 파운드리 공정에 맞게 변환·최적화**해주는 역할을 수행한다. 팹리스가 무엇을 만들지 설계하면, 디자인하우스는 이를 삼성 공정에서 실제로 구현 가능하도록 다듬어주는 **건축 설계사무소의 역할**을 맡는다. 또한 파운드리가 직접 접근하기 어려운 중소형 팹리스 고객을 발굴해 삼성 공정으로 연결해주는 영업 대리인 역할도 병행함으로써 생태계의 외연을 넓히는 데 기여한다. **주요 기업으로는 가온칩스, 에이디테크놀로지, 에이직랜드, 세미파이브** 등이 있다.

[소재·부품·장비 & OSAT] 인프라와 후공정

소재·부품·장비 및 OSAT 섹터는 파운드리 가동률 회복의 실질적인 낙수효과를 누리는 **하드웨어 기반**이다. 생산 라인이 풀 가동 체제에 진입하면 소모성 소재 및 부품의 공급량이 즉각적으로 확대되며, 초미세 공정 전환에 따른 기술 난도 상승은 고부가가치 장비에 대한 신규 투자를 유발한다. OSAT 업체는 가공된 웨이퍼의 검사 및 패키징 물량이 늘어남에 따라 가동률 상승에 따른 영업 레버리지 효과를 향유한다. **주요 기업으로는 소재** 부문의 동진썬미켄, 부품 부문의 에스앤에스텍, 장비 부문의 이오테크닉스·프로텍·HPSP, OSAT 부문의 두산테스나 등이 있다.

삼성 파운드리 가동률 반등과 공정 선단화에 따른 밸류체인별 수혜 강도는 비즈니스 모델의 구조적 특성과 비용 구조, 그리고 삼성전자와의 거래 방식에 따라 뚜렷한 차이를 보인다. 수혜 강도는 IP > 소재·부품 > DSP > 장비 순으로 판단되며, 그 근거는 다음과 같다.

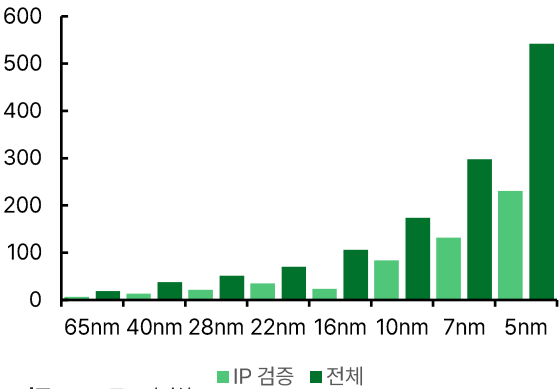
[IP] ★★★
공정 종속성에 기반한
영업 레버리지

IP 섹터가 밸류체인 내에서 가장 강력한 수혜를 입는 핵심 이유는 공정 종속성과 대체 불가능성에 있다. 반도체 IP는 공정 맞춤형으로 설계되는 특성상, 동일한 기능의 IP라 하더라도 삼성 파운드리 5나노용 도면과 3나노용 도면은 물리적 특성이 상이하여 새로운 설계 및 검증이 요구된다. 이에 따라 글로벌 팹리스가 삼성 파운드리를 선택하는 순간, 해당 공정에서 이미 검증이 완료된 IP 업체의 제품을 채택할 수밖에 없는 구조가 형성된다. 여기에 IP 비즈니스 고유의 극강의 영업 레버리지 효과가 더해진다. IP 기업의 비용 구조는 초기 R&D 인건비에 집중되는 고정비 중심으로, 특정 공정용 IP 개발이 완료된 이후에는 추가로 발생하는 변동비가 사실상 '0'에 수렴한다. 따라서 가동률 상승으로 라이선스 체결 건수가 증가할 경우, 매출 증가분의 대부분이 영업이익으로 직결되는 레버리지 효과가 극대화된다.

[소재 및 부품] ★★
가동률에 즉각 반응하는
실적 동행주

소재 및 부품 섹터는 가동률 회복에 따른 직접적인 수요 증가를 향유하며 견조한 수혜를 입는다. 이들은 웨이퍼를 투입할 때마다 소모되는 소모품적 성격을 지니고 있어, 삼성 파운드리 가동률이 상승하는 즉시 매출 확대로 이어지는 구조다. 생산량(Q) 증가가 소재·부품 수요 증가로 이어져, 실적이 가동률과 함께 동반 성장한 구조적 특성이 형성된다. 최근 삼성 파운드리 국산화 모멘텀이 수요 기반을 추가적으로 확대할 수 있다는 점도 긍정적 요인으로 작용한다.

공정별 칩 개발 비용 중 IP 검증 비용



자료: IBS, 그로스리서치

삼성 파운드리 밸류체인 주요 기업

구분	주요 기업
IP (설계 자산)	오픈엣지테크놀로지, 퀄리티스반도체
DSP (설계 대행)	가온칩스, 에이디테크놀로지, 에이직랜드, 세미파이브
소재·부품·장비	에스앤에스텍(부품), 동진세미켴(소재), 이오테크닉스, 프로텍, HPSP(장비)
OSAT (후공정)	두산테스나

자료: 그로스리서치

[DSP & 장비] ★
제한적 수혜 및 시차 발생

DSP 섹터는 팹리스와 파운드리를 잇는 기술적 연결 역할을 수행하지만, **수혜의 폭은 상대적으로 제한적**이다. **수익 구조가 인력 투입 중심의 프로젝트성 매출**에 의존하는 데다, 퀄컴·엔비디아 등 빅테크 고객사들이 DSP를 경유하지 않고 파운드리와 직접 소통하는 경향이 강해 삼성 파운드리 내의 **빅테크 수주 비중이 높아질수록 DSP의 실질 수혜는 타 섹터 대비 제한적일 것으로 판단**된다.. 다만 칩 설계부터 파운드리 양산 및 패키징까지 일괄 수행하는 턴키(Turn-Key) 계약 비중이 높은 업체일수록 상대적으로 DSP 섹터 내에 비교적 큰 수혜를 기대할 수 있다.

장비 섹터는 CAPEX의 후행적 특성으로 인해 수혜 강도가 밸류체인 내에서 가장 낮은 것으로 판단된다. 가동률이 50%에서 80%로 상승한다고 해서 즉각적인 신규 장비 발주로 이어지지 않으며, 가동률이 90% 이상에 도달하여 물리적 캐파 증설이 불가피해지는 시점해야 비로소 수혜가 현실화되는 구조다. 현재 **삼성 파운드리의 가동률이 본격적인 상승 초입 구간에 진입하고 있음을 감안하면, 장비 섹터의 실적 반영은 여타 섹터 대비 상당한 시차를 두고 나타날 것**으로 예상된다.

삼성파운드리가동률 상승에 따른 섹터별 수혜 강도



Part 4. 관련기업

삼성 파운드리 관련기업

기업명	기업개요	시가총액
오픈엠티테크놀로지	• '17년 설립, '22년 코스닥 상장 • 주요 사업: AI 반도체 통합 IP 솔루션 제공 • 매출 비중 : 라이선스 67.61%, 유지 보수 26.14%, 로열티 및 기타 6.25% • 메모리 컨트롤러 및 인터페이스 IP 분야 세계적 기술력 보유 • 삼성 파운드리 SAFE 파트너로서 생태계 핵심 역할 수행	4,194억원
켈리타스반도체	• '17년 설립, '23년 코스닥 상장 • 주요 사업: 초고속 인터페이스 IP 전문 기업 • 매출 비중 : MIPI IP 49.71%, Display Chipset IP 31.28%, 기타 19.01% • 핀펫(FinFET) 공정 기반 인터페이스 설계 기술 보유 • 삼성전자 파운드리 공정에 최적화된 고속 데이터 전송 IP 공급	1,945억원
가온칩스	• '12년 설립, '22년 코스닥 상장 • 주요 사업: 삼성 파운드리 최대 DSP(디자인 서비스 파트너) • 매출 비중 : Automotive 44.7%, AI 40.31%, 기타 14.99% • 선단 공정(5nm, 4nm, 3nm) 설계 최적화 전문성 보유 • 삼성전자 파운드리 공식 디자인 솔루션 파트너(DSP)	7,587억원
세미파이브	• '19년 설립, '25년 코스닥 상장 • 주요 사업: RISC-V 기반 커스텀 반도체 설계 플랫폼 전문 • 매출 비중 : ASIC 개발 서비스 56%, 양산 공급 17%, IP 등 기타 27% • 삼성 파운드리 핵심 DSP로서 글로벌 고객사 유입 촉진 • SoC 설계 자동화 플랫폼을 통한 개발 기간 및 비용 단축	1조 581억원
에스앤에스텍	• '01년 설립, '09년 상장 • 주요 사업: 국내 유일의 블랭크마스크 전문 제조 기업 • 매출 비중 : 블랭크마스크 96.3%, 기타 3.7% • 삼성전자가 지분 투자한 전략적 파트너 • EUV 블랭크마스크 및 펄리클 국산화의 핵심 주체	1조 8,326억
동진세미켐	• 1973년 설립, 1999년 상장 • 주요 사업: 반도체 및 디스플레이용 재료 전문 기업 • 매출 비중 : 전자재료 93%, 발포제 및 기타 7% • 국내 최초 ArF 및 EUV 포토레지스트 국산화 성공 • 삼성 파운드리 공정 내 핵심 소재 공급망 담당	2조 4,962억원

오픈엠티테크놀로지 (394280)

삼성의 핵심 IP 파트너사, 고정비를 수익으로 돌리는 압도적 영업 레버리지

투자 포인트

무형자산 기반의 영업 레버리지 극대화

삼성파운드리 채택에 따른 IP 업체의 높은 영업 레버리지 기대

동사는 '17년 설립된 기업으로, 글로벌 반도체 IP 시장 내에서 성능과 전력 효율을 최적화 한 통합 메모리 시스템 솔루션 제공자이면서 삼성 파운드리 생태계의 핵심 파트너로서 독보적인 입지를 다지고 있다. 이때 IP 비즈니스는 비용의 90% 이상이 인건비성 R&D 고정비로 구성되는 구조적 특성을 지닌다. 단일 IP 개발에 수백억 원이 선행 투입되나, 일단 검증 을 마친 IP는 무형자산의 복제 가능성 덕분에 추가 판매 시 한계 비용이 제로(0)에 수렴 하는 Ready Made 제품이 된다. 이에 따라 손익분기점(BEP) 돌파 시점부터 매출 증가가 곧바로 영업이익 폭증으로 연결되는 극강의 영업 레버리지 효과를 향유하며, 삼성 파운드리 고객사 확대에 따른 비선형적 이익 성장을 실현한다.

고난도 기술 영역, 견고한 진입장벽

PHY IP의 높은 진입장벽과 삼성 파운드리 친화력 동사의 핵심

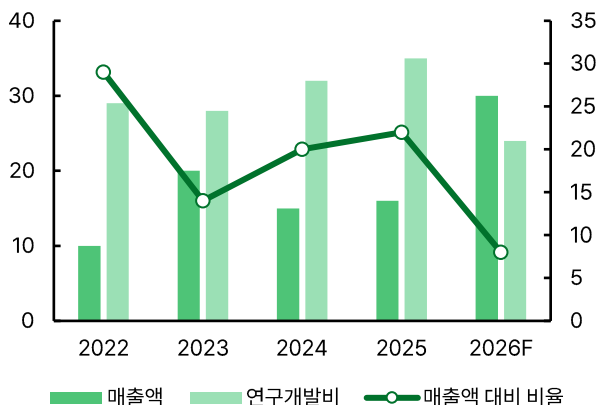
동사의 주력인 PHY(물리 계층) IP는 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환하는 '반도체 통신의 관문'으로, 미세 공정별 물리적 특성에 극도로 민감한 고난도 기술 영역이다. 각 공정마다 시제품 제작(MPW)을 통한 실제 칩 작동 여부(실리콘 검증)가 필수적이기에 막대한 자본과 시간이 소요되는 강력한 진입장벽을 형성한다. 이러한 기술적 폐쇄성은 신규 경쟁사의 진입을 차단하는 견고한 해자로 작용한다.

선제적이고 즉각적 수요 대응 가능

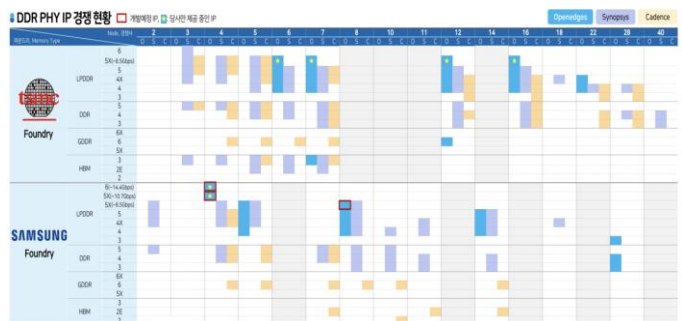
삼성 파운드리 선단 공정과의 전략적 동행 및 시장 선점 우위

동사는 삼성 파운드리의 SAFE 핵심 파트너로서 SF3(3나노), SF2(2나노) 등 최선단 공정의 개발 초기 단계부터 설계 사양을 공유하며 IP를 동시 개발하는 긴밀한 전략적 동맹을 유지하고 있다. 이러한 선제적 개발 전략은 팹리스 고객사가 삼성의 차세대 공정을 사용하고 자 할 때, 경쟁사가 대응하기 전 이미 검증된 IP를 즉시 제공할 수 있는 시간적 해자를 확보 해 준다. 결과적으로 삼성 파운드리 생태계가 본격적으로 개화함에 따라 고객들은 삼성 공정에 최적화되어 즉시 사용 가능한 동사의 IP를 필수적으로 선택하게 되며, 이는 동사가 시장 내에서 독점적 지위를 확보하는 강력한 기반이 된다.

매출-고정비 비중



동사 DDR PHY IP 경쟁 현황



자료 : DART, 그로스리서치

그로스리서치 GROWTH RESEARCH

자료 : 오픈엠티테크놀로지, 그로스리서치

에스앤에스텍 (101490)

국내 유일의 블랭크마스크 전문 기업. 공정 국산화의 최전선 파트너

투자 포인트

일본 독점 체제 타파 + 공급망 실익 선점

EUV 블랭크마스크 국산화: 일본 독점 체제 타파와 공급망 실익 선점

동사는 '01년 설립된 국내 유일의 블랭크마스크 전문 기업으로서, 삼성전자의 선단 공정 국산화 전략의 최전선에 위치하고 있다. 그동안 삼성전자는 초미세 공정의 극도로 높은 수율 민감도로 인해 일본의 호야(HOYA)와 아사히글라스(AGC)가 독점해온 EUV 블랭크마스크를 보수적으로 채택해왔다. 그러나 최근 에스앤에스텍의 제품이 삼성전자의 까다로운 최종 신뢰성 테스트 막바지 단계에 진입하며 국산화의 실질적인 전기를 마련했다. **'26년 내 실제 양산 라인 투입이 유력시됨에 따라, 동사는 단순한 소재 공급사를 넘어 삼성 파운드리 선단 공정의 핵심 파트너로 격상될 전망이다.** 이는 그간 주가 상승을 억눌렀던 기술적 불확실성을 해소하여, 점유율 증가에 대한 기대로 리레이팅 국면이라 판단된다.

고부가가치 제품 믹스 → 수익성 수직 상승

P(단가)의 구조적 레벨업: 고부가가치 제품 믹스 개선에 따른 수익성 수직 상승

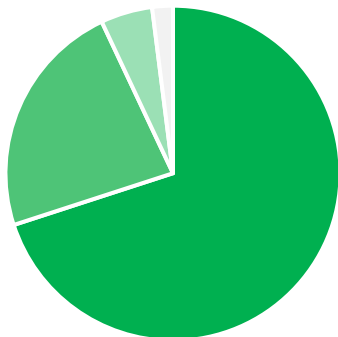
동사의 기존 주력 매출원이었던 DUV(심자외선)용 블랭크마스크와 비교할 때, EUV용 제품은 기술적 난이도가 압도적으로 높아 단가가 수십 배 이상 비싸게 형성되어 있다. 따라서 '26년부터 시작될 EUV 블랭크마스크의 매출 비중 확대는 동사의 전사 영업이익률을 수직 상승시키는 결과를 초래한다. **저부가가치 제품 위주의 사업 구조가 고부가 선단 공정 중심으로 재편되면서, 가동률 상승에 따른 매출 증대의 질적 성장 구간에 진입하게 된다.**

미세 공정화에 따른 레이어 수의 동반 상승

Q(수량)의 기하급수적 팽창: 미세 공정화에 따른 레이어 수의 동반 상승

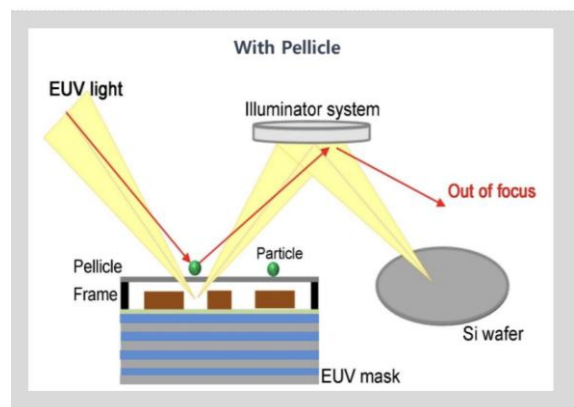
삼성 파운드리 공정이 미세화되는 추세에 따르면, 웨이퍼 한 장에 노광 공정을 수행해야 하는 EUV 레이어(Layer) 수가 기하급수적으로 증가한다. 특히 2나노 공정에서는 EUV 레이어가 40개 이상으로 늘어날 것으로 예상되는데, 이는 곧 웨이퍼당 소모되는 블랭크마스크의 절대적인 수량 증가를 의미한다. 삼성 파운드리 고객사 수주 확대에 따른 **전체 웨이퍼 투입량 증가와 선단 공정 비중 확대에 따른 웨이퍼당 레이어 수 증가가 결합되는 이중 수혜 구조가 형성된다.** 결과적으로 블랭크마스크의 교체 주기가 단축되고 소모량이 급증하며 Q의 폭발적인 성장이 기대된다.

블랭크마스크 점유율



■ 호야 ■ 신에쓰 ■ 에스앤에스텍 ■ 울코트

동사 EUV Pellicle



자료 : 에스앤에스텍, 그로스리서치

Compliance Notice

- 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 동 자료는 투자 판단을 위한 정보제공 및 교육용일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다.
- 투자판단은 본인 스스로 하며, 투자행위와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 해당 자료를 전문투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 작성자는 해당 기업의 유가증권을 발간 전에 보유하고 있지 않으며, 발간 후에 매수·매도할 수 있습니다.
- 동 자료에 대한 저작권은 그로쓰리서치에 있습니다. 당사의 허락 없이 무단복사 및 복제, 대여를 할 수 없습니다.